

27. Juni 2023

Halbleiter aus Spanien von KDPOF

Europäische Kommission vergibt an KDPOF zusammen mit drei spanischen Unternehmen Zugang zum 8,1 Milliarden Euro Investitionsprogramm IPCEI zur Chipentwicklung

Madrid (Spanien) – KDPOF (ein führender Anbieter für Gigabit-Konnektivität über Faseroptik in rauer Umgebung) gibt stolz bekannt, dass die Europäische Kommission den Zugang zu den 8,1 Milliarden europäischen Investitionen für das geplante Packaging-Werk für optoelektronische Bauteile in Spanien gewährt.

„Die Finanzierung unterstützt uns beim Verwirklichen unserer Pläne, in naher Zukunft ICs in Europa herzustellen“, erläutert Carlos Pardo, CEO und Mitgründer von KDPOF. „Europäische Fabs stellen nur etwa 10 Prozent der Halbleiter weltweit her, was uns von Asien und den Vereinigten Staaten abhängig macht. Wir leisten Pionierarbeit bei der Produktion von Optoelektronik für die Automobilindustrie in hohen Stückzahlen in Spanien und reduzieren damit die Abhängigkeit.“



Image 1: KDPOF erhält IPCEI-Investitionen für den Bau eines Packaging-Werks für Optoelektronik in Spanien

In der Nähe ihres Hauptsitzes in Tres Cantos, Madrid, baut KDPOF ein hochwertiges Packaging-Werk für modernste optoelektronische Bauteile. Darüber hinaus entwickelt KDPOF eine neue und innovative Packaging-Technologie für Optoelektronik. Sie kommt erstmals bei der Produktion des kommenden Transceiver-ICs für die optische Highspeed-Kommunikation in Fahrzeugen zum Einsatz.

Die Integration von KI, Sensoren und Prozessoren in selbstfahrende Fahrzeuge erfordert die Technologie von KDPOF, um alle Komponenten robust und kostengünstig über Glasfaser innerhalb des Fahrzeugs miteinander zu verbinden. Seit 2014, mit der Einführung des ersten Transceivers, ist KDPOF führend in der optischen Highspeed-Kommunikation für die Automobilindustrie und hat internationale Kunden wie Daimler.

IC-Produktion: Silizium-Wafer, Assembly und Test

Die Produktion eines Halbleiters besteht aus drei grundlegenden Prozessen: Der erste ist die Herstellung eines Siliziumwafers, der als Basis für den Mikrochip dient. Der zweite besteht aus der Montage und der dritte umfasst das Testen zum Sicherstellen der Qualität. Es sind die letzten beiden Schritte, die KDPOF nach Tres Cantos bringt.

„Die Herstellung des Siliziumwafers ist ein Prozess, der nur mit sehr großen Stückzahlen profitabel ist, und sich damit für ein kleines Unternehmen kaum rechnen kann“, fügt Carlos Pardo hinzu. „Für die beiden letzten Phasen, d. h. Assembly und Test, sind die benötigten Maschinen relativ kostengünstig. Diese Phasen lassen sich mit geringeren Stückzahlen durchführen, wie wir sie aktuell in der Automobilindustrie haben. Wir freuen uns darauf, in Madrid eine Montage- und Testfab für große Stückzahlen zu bauen.“

EU-Fördermittel für Mikroelektronik in Europa

Die Europäische Kommission hat nach den EU-Beihilfavorschriften ein „wichtiges Projekt von gemeinsamem europäischem Interesse“ (Important Project of Common European Interest, IPCEI) genehmigt, um Forschung, Innovation und den ersten industriellen Einsatz von Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien in der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen. Das Projekt mit der Bezeichnung "IPCEI ME/CT" wurde von 14 Mitgliedsstaaten gemeinsam vorbereitet und angekündigt: Österreich, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Malta, Niederlande, Polen, Rumänien, Slowakei und Spanien. Die Mitgliedstaaten werden bis zu 8,1 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln zur Verfügung stellen, die zusätzliche 13,7 Milliarden Euro an privaten Investitionen freisetzen sollen. An dem Projekt sind 56 Unternehmen beteiligt.

Zu den spanischen Unternehmen gehören Innova IRV Microelectronics, KDPOF, Openchip und Semidynamics Technology Services. Der Vorschlag sieht eine Entwicklungsfrist bis 2032 vor, wobei die Kommerzialisierung der Produkte ab 2025 erfolgen soll. Es wird auch erwartet, dass diese 68 Projekte insgesamt 8.700 direkte Arbeitsplätze schaffen.

Zeichen: 3.992

Weitere Informationen zum „IPCEI ME/CT“:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_3087

Keywords: KDPOF, IPCEI, European commission, packaging plant, microelectronics, optoelectronics, IC testing, fiber optics, KD1053, KD9351, KD7251, gigabit, automotive, automotive Ethernet, in-vehicle connectivity, automotive network, AI, artificial intelligence, autonomous vehicle, automated driving, connected vehicles, EMC, EMC-safe, photonics, multi-gigabit, Carlos Pardo

Bilder

Bild 1: KDPOF erhält IPCEI-Investitionen für den Bau eines Packaging-Werks für Optoelektronik in Spanien
Bildquelle/Copyright: KDPOF

Download: <https://www.ahlandorf-news.com/media/news/images/KDPOF-packaging-plant-madrid-spain-H.jpg>

Bild 2: Carlos Pardo ist CEO und Mitgründer von KDPOF

Bildquelle/Copyright: KDPOF

Download: <https://www.ahlandorf-news.com/media/news/images/KDPOF-Pardo-Carlos-4-H.jpg>



Über KDPOF

Das Fabless-Halbleiterunternehmen KDPOF bietet innovative optische Hochgeschwindigkeitsnetzwerke in rauer Umgebung. KDPOF hat die Gigabit-Kommunikation über optische Overstep-Index-Kunststofffasern (SI-POF) für die Automobilindustrie realisiert. Das 2010 in Madrid, Spanien, gegründete Unternehmen bietet seine kosteneffiziente Technologie als vollständiges Automotive-qualifizierte ASSP (Application Specific Standard Product) an. Die Technologie von KDPOF nutzt innovative digitale adaptive Algorithmen, um die Empfindlichkeit des Empfängers zu maximieren. Dabei unterstützen die Lösungen eine ertragreiche und zuverlässige optoelektronische Produktion in kostengünstigen Bulk-CMOS-Tiefsubmikron-Knoten. So gewährleistet KDPOF den Automobilherstellern niedrige Risiken, geringe Kosten und kurze Markteinführungszeiten. Weitere Informationen stehen unter <https://www.kdpof.com> zur Verfügung.

Medienkontakt:

Mandy Ahlendorf

ahlendorf communication

E-Mail: ma@ahlendorf-communication.com

Phone: +49 89 41109402